

无锡泰连芯科技有限公司

TLX1G08 型

单 2 输入正与门

2024 年 06 月

TLX1G08 单 2 输入正与门

1 特点

- 工作电压范围：**1.65V 至 5.5V**
- 低功耗：**1μA**（最大值）
- 工作温度范围：
-55 °C 至 125 °C
- 输入接受电压达 **5.5V**
- 高输出驱动：**±24mA**（**V_{CC}=3.0V** 时）
- 微型封装：**SOT23-5、SC70-5、XDFN1X1-6**

2 应用

- 主动降噪
- 条形码扫描器
- 血压监测仪
- 持续气道正压通气机
- 指纹识别
- 网络附加存储 (NAS)

3 描述

TLX1G08 单 2 输入正与门设计用于 1.65V 至 5.5V_{V_{CC}} 操作。

TLX1G08 器件以正逻辑执行布尔函数 $Y=A \cdot B$ 或 $Y=$ 。该器件完全适用于使用 $\overline{A} + \overline{B}$ 的部分断电应用。I_{off} 电路可禁用输出，防止器件断电时电流回流造成损坏。

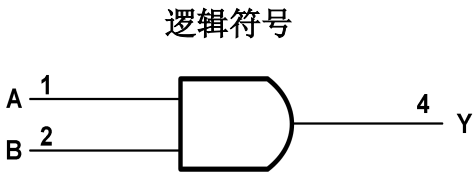
TLX1G08 采用绿色 SOT23-5、SC70-5 和 XDFN1X1-6 封装。其工作环境温度范围为 -55 °C 至 125 °C。

质量等级：军温级&N1级

设备信息⁽¹⁾

产品编号	封装	主体尺寸（标称）
TLX1G08	SOT23-5	2.92mm×1.60mm
	SC70-5	2.10mm×1.25mm
	XDFN1X1-6	1.00mm×1.00mm

(1) 要了解所有可用的封装，请参阅数据表末尾的可订购附录。



4 功能表

输入		输出
A	B	Y
H	H	H
L	H	L
H	L	L
L	L	L

Y=A•B
H=高电压电平
L=低电压等级

目录

1 特点	2
2 应用	2
3 描述	2
4 功能表	2
5 修订历史	4
6 封装/订购信息 ⁽¹⁾	5
7 引脚配置	6
8 规格	7
8.1 绝对最大额定值	7
8.2 ESD 额定值	7
9 电气特性	8
9.1 建议的工作条件	8
9.2 直流特性	9
9.3 交流特性	9
10 参数测量信息	10
11 封装外形尺寸	11
12 卷带信息	14

5 修订历史

注意：以前修订的页码可能与当前版本的页码不同。

版本	更改日期	更改项目
A.1	2020/12/12	初始版本完成
A.2	2021/04/12	t_{pd} 的典型值
A.3	2021/11/26	添加了卷带信息
A.4	2022/04/27	更新 RevA.3 第 5 页的封装标记
A.5	2023/09/26	1.添加 MSL 2.添加 DFN1X1-6L 封装
A.6	2023/11/02	1.更新 RevA.5 第 1 页的功能 RevA.5 第 4 页新增标记信息 3. 更新封装热阻抗 和 ESD 额定值见 RevA.5 第 6 页
A.6.1	2024/02/28	修改包装命名
A.6.2	2024/09/23	1.更新 MSL 说明 2.更新 XDFN1X1-6 Pin1 RevA.6.1 第 13 页的象限 3.更新 ESD 等级描述
A.7	2025/03/01	1. 更新 V_{IL} 参数 2.更新 ESD 等级

6 封装/订购信息⁽¹⁾

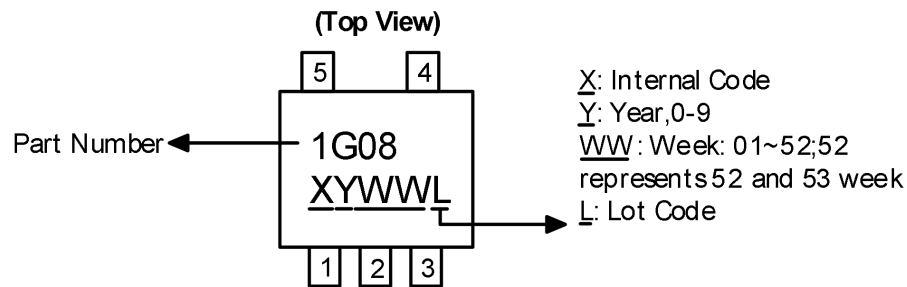
订购型号	温度等级	封装类型	MSL	质量等级
JTLX1G08XF5	-55 ℃ ~+125 ℃	SOT23-5	MSL1/3	N1/军温级
JTLX1G08XC5	-55 ℃ ~+125 ℃	SC70-5 ⁽⁵⁾	MSL1/3	N1/军温级
JTLX1G08XUTDN6	-55 ℃ ~+125 ℃	XDFN1X1-6	MSL1/3	N1/军温级
TLX1G08XF5	-40 ℃ ~+125 ℃	SOT23-5	MSL1/3	工业级
TLX1G08XC5	-40 ℃ ~+125 ℃	SC70-5 ⁽⁵⁾	MSL1/3	工业级
TLX1G08XUTDN6	-40 ℃ ~+125 ℃	XDFN1X1-6	MSL1/3	工业级

笔记:

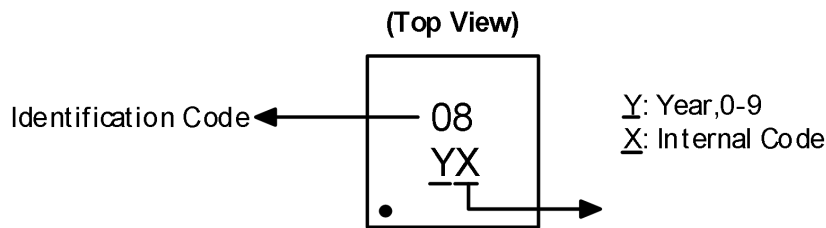
- (1) 此信息是指定设备的最新可用数据。此数据如有更改，恕不另行通知，也不会修订本文档。如需此数据表的浏览器版本，请参阅右侧导航。
- (2) 可能还有额外的标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码）、设备上的徽标或环境类别。
- (3) TLXIC 使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的组装工厂中的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类，如果您的最终应用对预处理设置非常关键或者您有特殊要求，请与 TLXIC 保持一致。
- (4) 08: 识别码。
- (5) 相当于 SOT353。

标记信息

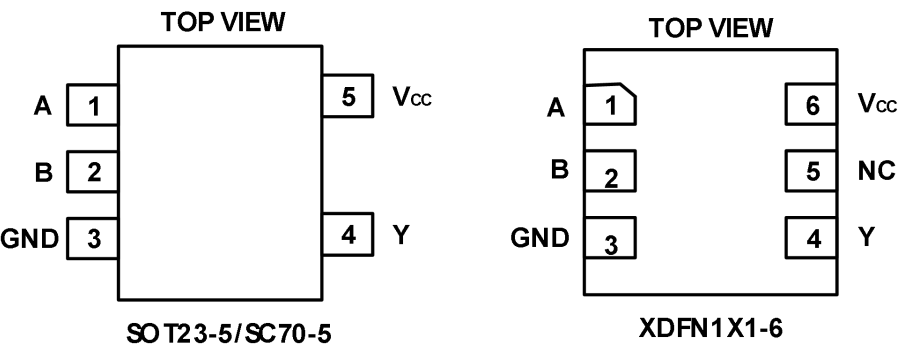
(1) SOT23-5, SC70-5



(2) DFN1X1-6



7 引脚配置



引脚描述

引脚		代码	I/O ⁽¹⁾	功能
SOT23-5/SC70-5	DFN1X1-6			
1	1	A	I	输入
2	2	B	I	输入
3	3	GND	-	接地
4	4	Y	O	Y 输出
-	5	NC	-	未连接
5	6	V _{CC}	-	电源引脚

(1) I=输入，O=输出。

8 规格

8.1 绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）⁽¹⁾⁽²⁾

			最小	最大	单位
V_{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	在高阻抗或断电状态下施加到任何输出的电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	施加到高状态或低状态的任何输出的电压范围 ⁽²⁾⁽³⁾		-0.5	$V_{CC}+0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$V_I < 0$		-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$V_O < 0$		-50	mA
I_O	连续输出电流			±50	mA
	持续电流通过 V_{CC} 或 GND			±100	mA
θ_{JA}	封装热阻 ⁽⁴⁾	SOT23-5		208	°C/W
		SC70-5		283	
		XDFN1X1-6		438	
T_J	结温 ⁽⁵⁾		-55	125	°C
T_{stg}	存储温度		-55	150	°C

(1) 超出绝对最大额定值所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些只是应力额定值，并不表示器件在这些条件下或超出建议工作条件所列的任何其他条件下能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超出输入和输出负电压额定值。

(3) 建议工作条件表中提供了 V_{CC} 的值。

(4) 封装热阻按照 JESD-51 计算。

(5) 最大功耗是 $T_J (MAX)$ 、 $R_{\theta JA}$ 和 T_A 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 $P_D = (T_J (MAX) - T_A) / R_{\theta JA}$ 。所有数字适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

8.2 ESD 额定值

以下 ESD 信息仅适用于在 ESD 保护区域内处理 ESD 敏感设备。

			数值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型 (HBM)，符合 EIA/JESD22-a114，所有引脚	±4000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JS-002，所有引脚	±1000	V
		机械模型 (MM)，符合 EIA/JESD22-a115，所有引脚	±200	V



ESD 敏感度警告

ESD 损坏的范围从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路更容易受到损坏，因为非常小的参数变化都可能导致设备不符合其公布的规格。

9 电气特性

在建议的工作自然通风温度范围内（除非另有说明，典型值均为 $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 。）⁽¹⁾

9.1 建议工作条件

范围	代码	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	操作	1.65	5.5	V
		仅保留数据	1.5	5.5	
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=1.65\text{V to }1.95\text{V}$	$0.65 \times V_{CC}$		V
		$V_{CC}=2.3\text{V to }2.7\text{V}$	1.7		
		$V_{CC}=3\text{V to }3.6\text{V}$	2.2		
		$V_{CC}=4.5\text{V to }5.5\text{V}$	$0.7 \times V_{CC}$		
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=1.65\text{V to }1.95\text{V}$		$0.3 \times V_{CC}$	V
		$V_{CC}=2.3\text{V to }2.7\text{V}$		0.7	
		$V_{CC}=3\text{V to }3.6\text{V}$		0.8	
		$V_{CC}=4.5\text{V to }5.5\text{V}$		$0.3 \times V_{CC}$	
输入电压	V_I		0	5.5	V
输出电压	V_O		0	V_{CC}	V
输入转换上升或下降	t_r, t_f	$V_{CC}=1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}, 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$		20	ns/V
		$V_{CC}=3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$		10	
		$V_{CC}=5\text{V} \pm 0.5\text{V}$		5	
工作温度	T_A		-55	+125	$^{\circ}\text{C}$

(1) 器件的所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND，以确保器件正常运行。

9.2 直流特性

范围		测试条件	电压	温度	最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
V _{OH}		I _{OH} = -100μA	1.65V to 5.5V	Full	V _{CC} -0.1			V
		I _{OH} = -4mA	1.65V		1.2			
		I _{OH} = -8mA	2.3V		1.9			
		I _{OH} = -16mA	3V		2.4			
		I _{OH} = -24mA			2.3			
		I _{OH} = -32mA	4.5V		3.8			
V _{OL}		I _{OL} = 100μA	1.65V to 5.5V	Full			0.1	V
		I _{OL} = 4mA	1.65V				0.45	
		I _{OL} = 8mA	2.3V				0.3	
		I _{OL} = 16mA	3V				0.4	
		I _{OL} = 24mA					0.55	
		I _{OL} = 32mA	4.5V				0.55	
I _I	A 或 B 输入	V _I =5.5V or GND	0V to 5.5V	+25°C		±0.1	±1	μA
				Full			±5	
I _{off}		V _I or V _O =5.5V	0	+25°C		±0.1	±1	μA
				Full			±10	
I _{CC}		V _I =5.5V or GND, I _O =0	1.65V to 5.5V	+25°C		0.1	1	μA
				Full			10	
ΔI _{CC}		一个输入为 V _{CC} -0.6V, 其他输入为 V _{CC} 或 GND	3V to 5.5V	Full			500	μA

(1) 器件的所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND, 以确保器件正常运行。

(2) 限值是在 25°C 下进行 100% 生产测试的。工作温度范围内的限值通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保。

(3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间而变化, 也取决于应用和配置。

9.3 交流特性

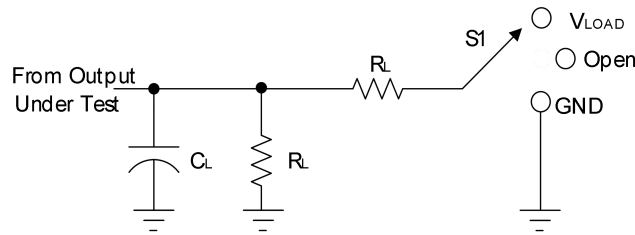
范围	代码	测试条件		最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
传播延迟	t_{pd}	$V_{CC}=1.8V\pm 0.15V$	$C_L=30pF, R_L=1k\Omega$		11.6		ns
		$V_{CC}=2.5V\pm 0.2V$	$C_L=30pF, R_L=500\Omega$		6.6		
		$V_{CC}=3.3V\pm 0.3V$	$C_L=50pF, R_L=500\Omega$		5.4		
		$V_{CC}=5V\pm 0.5V$	$C_L=50pF, R_L=500\Omega$		4.3		
输入电容	C_i	$V_{CC}=0V$			4		pF
功率耗散电容	C_{pd}	$V_{CC}=3.3V$	$f=10MHz$		26		pF
		$V_{CC}=5V$			31		

(1) 器件的所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND, 以确保器件正常运行。

(2) 此参数由设计和/或特性确保, 并未在生产中测试。

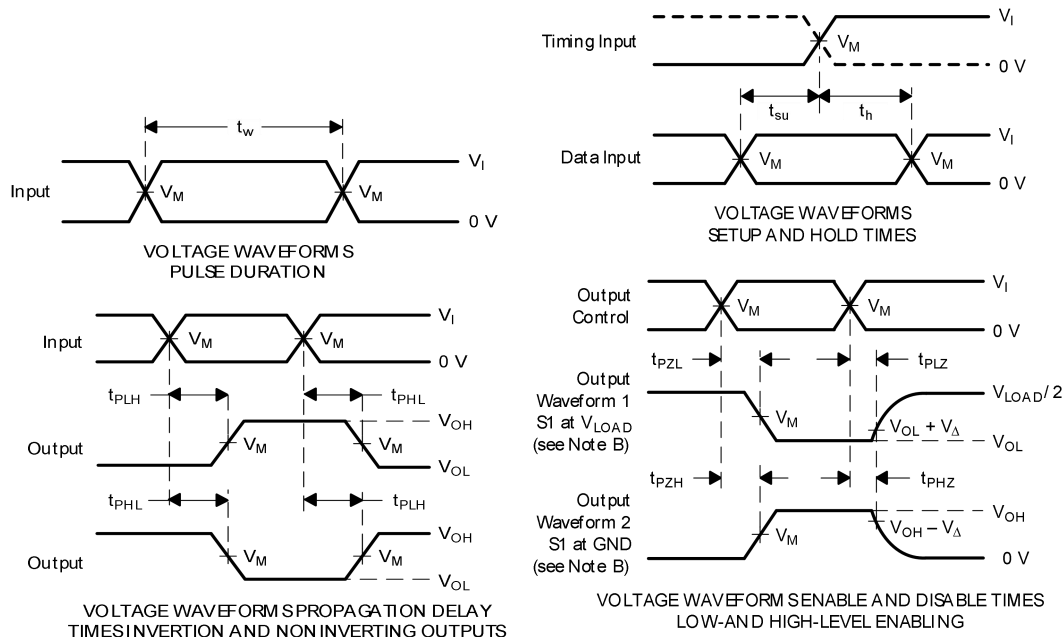
(3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间而变化, 也取决于应用和配置。

10 参数测量信息



测试	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_{Δ}
	V_I	t_r/t_f					
$1.8V \pm 0.15V$	V_{CC}	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30pF	1k Ω	0.15V
$2.5V \pm 0.2V$	V_{CC}	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30pF	500 Ω	0.15V
$3.3V \pm 0.3V$	3V	$\leq 2.5ns$	1.5V	6V	50pF	500 Ω	0.3V
$5V \pm 0.5V$	V_{CC}	$\leq 2.5ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	50pF	500 Ω	0.3V



注意：A.C_L包括探头和夹具电容。

B. 波形 1 用于具有内部条件的输出，即输出为低，除非被输出控制禁用。

波形 2 用于具有内部条件的输出，即输出为高电平，除非被输出控制禁用。

C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：PRR \leq 10MHz， $Z_0 = 50\Omega$ 。

D. 每次测量一个输出，每次测量一个转换。

E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 相同。

F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 相同。

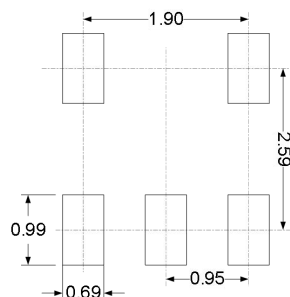
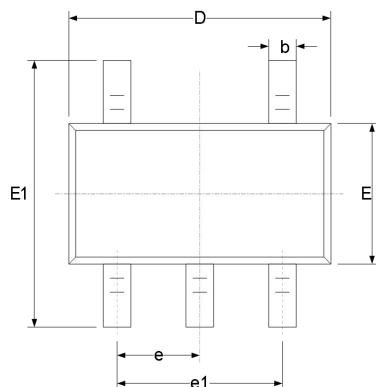
G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 与 t_{pd} 相同。

H. 并非所有参数和波形都适用于所有设备。

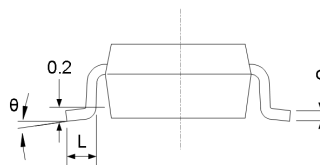
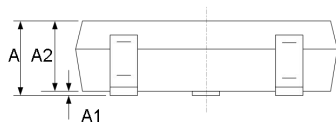
图 1. 负载电路和电压波形

11 封装外形尺寸

SOT23-5⁽³⁾



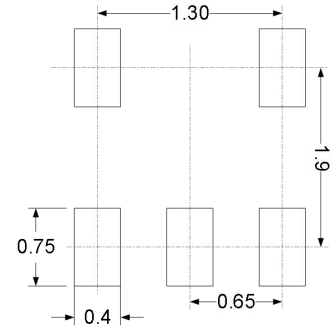
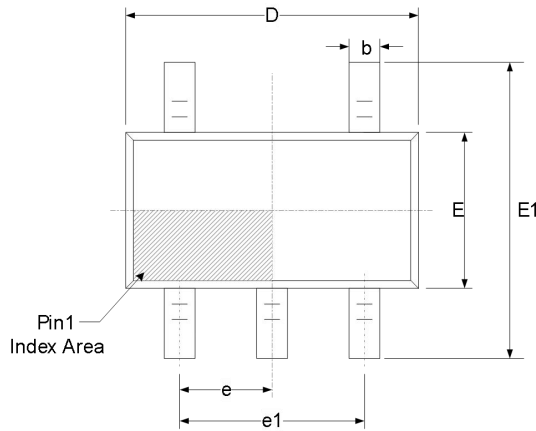
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



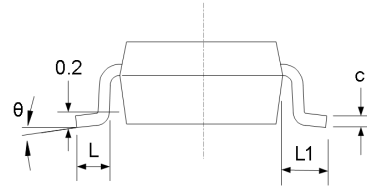
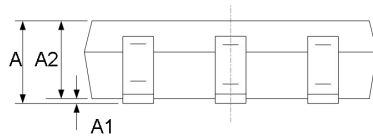
代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.820	3.020	0.111	0.119
E ⁽¹⁾	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) ⁽²⁾		0.037(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

SC70-5⁽³⁾

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

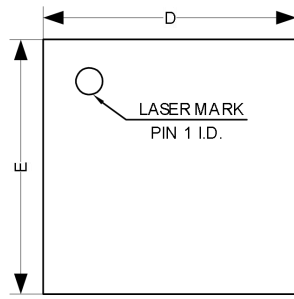


代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D ⁽¹⁾	2.000	2.200	0.079	0.087
E ⁽¹⁾	1.150	1.350	0.045	0.053
E1	2.150	2.450	0.085	0.096
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.300(BSC) ⁽²⁾		0.051(BSC) ⁽²⁾	
L	0.260	0.460	0.010	0.018
L1	0.525		0.021	
θ	0°	8°	0°	8°

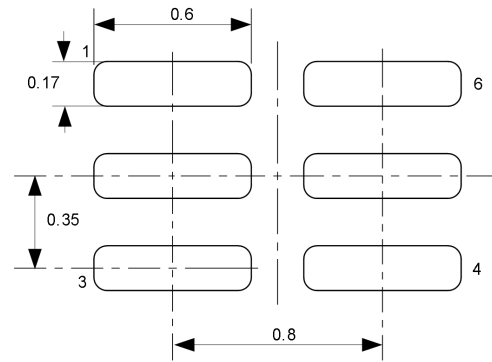
笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

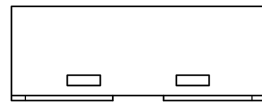
DFN1X1-6⁽³⁾



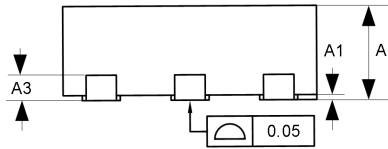
TOP VIEW



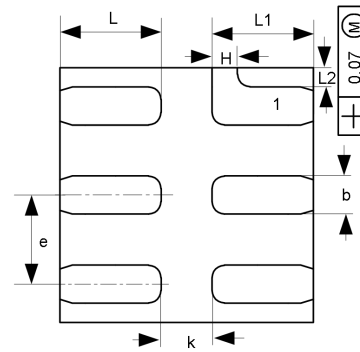
LAND PATTERN EXAMPLE



SIDEVIEW



SIDEVIEW



BOTTOM VIEW

代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.340	0.400	0.013	0.016
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.100 (REF) ⁽²⁾		0.004 (REF) ⁽²⁾	
b	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	0.950	1.050	0.037	0.041
E ⁽¹⁾	0.950	1.050	0.037	0.041
e	0.300	0.400	0.012	0.016
H	0.100 (REF) ⁽²⁾		0.004 (REF) ⁽²⁾	
K	0.150		0.006	
L	0.350	0.450	0.014	0.018
L1	0.350	0.450	0.014	0.018
L2	0.075 (REF) ⁽²⁾		0.003 (REF) ⁽²⁾	

笔记:

1
每侧最
毫米的塑料或金属突起。

2. REF 是 Reference 的缩写。

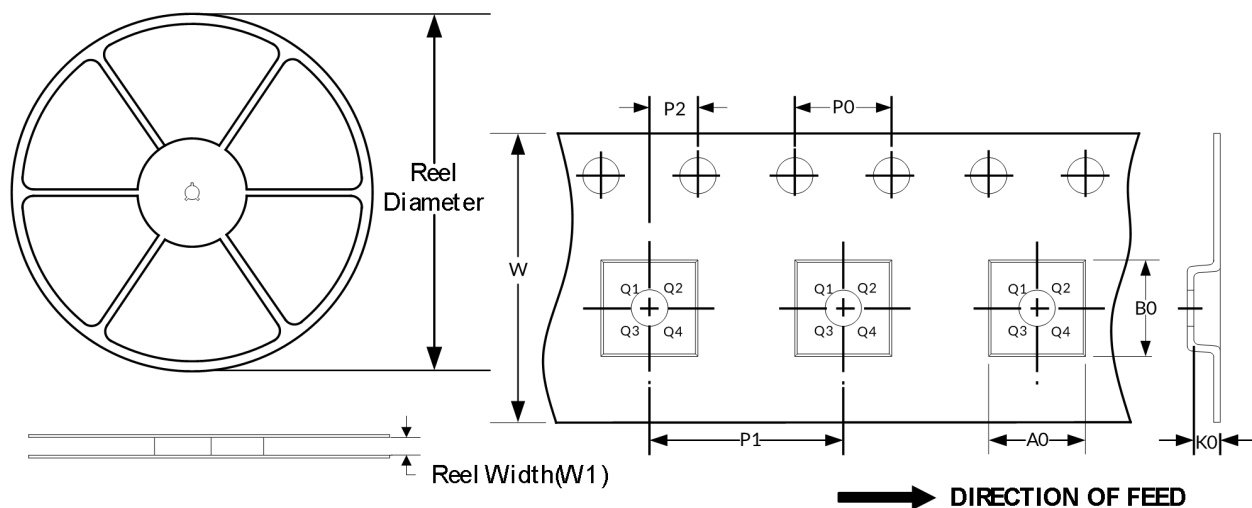
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

不包括
大 0.075

12 卷带信息

卷轴尺寸

胶带尺寸



注：图片仅供参考，请以实物为准。

卷带包装关键参数表

封装类型	卷轴直径	卷筒宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	脚 1 象限
SC70-5	7"	9.5	2.25	2.55	1.20	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
SOT23-5	7"	9.5	3.20	3.20	1.40	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
XDFN1X1-6	7"	9.5	1.14	1.17	0.56	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3

笔记：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。